ETEC EURO ALBINO DE SOUZA NOVOTEC – ELETRÔNICA

Gustavo Henrique Gonçalves Aguiar

NOMENCLATURA E ENCAPSULAMENTOS DE COMPONENTES
SMD

MOGI GUAÇU – SP 2023

Gustavo Henrique Gonçalves Aguiar

NOMENCLATURA E ENCAPSULAMENTOS DE COMPONENTES SMD

Relatório técnico apresentado a Etec Euro Albino de Souza, do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza como requisito para a obtenção da menção na disciplina de Microeletrônica sob a orientação do Prof. Cicero Augusto Queiroz de Mello.

MOGI GUAÇU – SP 2023 **RESUMO**

O resumo é um compilado com os principais elementos tratados no seu

trabalho e, por meio dele, os leitores saberão o tema, o objetivo, o

desenvolvimento utilizado, os resultados encontrados e a conclusão da

pesquisa. O resumo deve ser conciso, claro e objetivo, pois é apenas

um guia do trabalho.

Palavras-Chaves: Palavra1, Palavra2, Palavra3.

SUMÁRIO

1	INT	INTRODUÇÃO		
2	DESENVOLVIMENTO		/OLVIMENTO	5
2	2.1	Obj	ObjetivosComponentes eletrônicos SMD	
2	2.2	Con		
	2.3	Tipo		
	2.4	Con	nponentes passivos	6
	2.4.	1	Encapsulamento	6
	2.4.2		Resistores	6
	2.4.	3	Capacitores	7
	2.4.	4	Indutores	7
	2.5	COI	MPONENTES ATIVOS	8
	2.5.	1	Encapsulamento	8
	2.5.	2	Diodos	9
	2.5.	3	Transistores	9
	2.5.	4	Circuitos Integrados (CIs)	. 10
3	CONSIDERAÇÕES FINAIS			. 10
RE	REFERENCIAS			
A١	ANEXOS			

1 INTRODUÇÃO

SMD (*Surface Mounted Device* - traduzido do inglês: Dispositivo de Montagem em Superfície) são os dispositivos que utilizam da tecnologia SMT, uma sigla para *Surface-Mout Technology*, em tradução para o português significa Tecnologia de Montagem em Superfície. SMT junto ao SMD permitiram uma grande evolução em circuitos eletrônicos desde baixo custo até a tamanho reduzido e alta performance. Existem uma grande variedade de dispositivos SMD, capacitores, resistores, indutores, CI's, entre outros, esses dispositivos serão apresentados a seguir.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Objetivos

Esse relatório traz como principal objetivo a descrição de componentes SMD com exemplos de placas de circuito impresso que os utilizam.

2.2 Componentes eletrônicos SMD

São micro-componentes utilizados no processo de montagem de placa PCB (*Printed Circuit Board*), esses componentes ajudam a economizar em vários aspectos, são componentes menores e não se faz necessário utilizar os dois lados de uma placa o que traz a economia de espaço e tempo, outro benefício é a economia financeira logo que normalmente componentes SMD tem um custo menor comparado a componentes PTH (*Pin Through-hole* que em tradução direta fica Pino Através do Furo). Vide Figura 1.

PTH SMD Placa de Circuito Impresso

Figura 1 - Diferença entre SMD e PHT

Fonte: Nome, Data.

2.3 Tipos de encapsulamentos

Existe uma infinidade de encapsulamentos de componentes SMD, que são divididos em duas categorias, em passivos e ativos. Os encapsulamentos passivos têm como característica não precisar de uma polarização para que

funcionem de acordo com o esperado, são utilizados nos resistores, capacitores e indutores. Já os encapsulamentos ativos, diferente dos passivos, precisam de uma polarização para funcionar, podendo usar como exemplo o diodo, o transistor e reguladores de tensão.

2.4 Componentes passivos

2.4.1 Encapsulamento

São alguns exemplos de encapsulamentos de componentes passivos: MELF, LW e específicos. O encapsulamento MELF (*Metal Electrode Leadless Face*) é um encapsulamento de vidro em formato cilíndrico e o valor do componente podendo ser representado por faixas ou números. Vide Figura 2. O encapsulamento LW (*length width*) é um encapsulamento relacionado ao tamanho do componente, normalmente em décimos de milímetros ou em centésimos de polegadas do comprimento e a largura do componente.



Figura 2 - Encapsulamento MELF (Resistor)

Fonte: Nome, Data.

2.4.2 Resistores

Resistores são componentes passivos cujo objetivo é limitar a corrente num circuito, em SMD eles se apresentam em diversos encapsulamentos e seus valores podem ser representados por faixas ou números, sua unidade de medida é o Ohm. Veja a Figura 3.

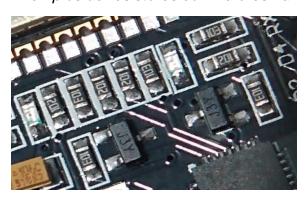


Figura 3 - Exemplos de resistores com valores numéricos

Fonte: Nome, Data.

(breve descrição desses resistores)...

2.4.3 Capacitores

Capacitores são dispositivos que armazenam cargas elétricas, por conta dessa sua característica podem ser usados para diversas coisas desde um temporizador por conta da sua rápida descarga até um retificador. Como um componente SMD o capacitor pode se apresentar com diversos encapsulamento e seu valor pode ser expresso pelo seu tamanho ou por números também e sua unidade de medida é o Farad. Veja a (Foto de um capacitor).

Figura 4 - Exemplo de capacitor SMD



Fonte: Nome, Data.

(breve descrição do capacitor da imagem).

2.4.4 Indutores

Os indutores, também chamado de bobina, é um componente passivo que armazena energia gerada por um campo magnético de corrente alternada. Indutores SMD normalmente apresentam um tamanho reduzido e seu valor expresso na parte superior do componente, os indutores têm como unidade de medida o Henry. Veja um exemplo na Figura 5.

Figura 5 - Indutor SMD



Fonte: Nome, Data.

(breve descrição do indutor da imagem).

2.5 COMPONENTES ATIVOS

2.5.1 Encapsulamento

Os componentes ativos são componentes que precisam ser polarizados corretamente para ser utilizados, um exemplo são os diodos e os transistores. Esses componentes têm tipos de encapsulamentos diferente do encapsulamento dos componentes passivos. São alguns exemplos de encapsulamentos de componentes ativos: SOT, DPAK, DUAL-IN_LINE (SOIC), GRID ARRAYS (BGA). Será usado 3 tipos de encapsulamentos bem comuns para exemplos, o SOT, DPAK e o BGA.

O encapsulamento SOT (*Small Outline Trasistor*) é um encapsulamento para transistores diodos e CIs, é um encapsulamento bem comum, portanto, não é difícil encontrá-lo. O encapsulamento DPAK (*Discrete Packaging*) é criado para dispositivos que dissipam altas potências, como driver de corrente e reguladores de tensão, esse encapsulamento também é usado em transistores, diodos e Cis. O encapsulamento BGA (*Ball Grid Array*) é um encapsulamento encontrado em placas de computadores e notebooks, são essencialmente para os processadores, portanto, em placas mais diversas pode ser difícil encontrar. Veja alguns tipos de encapsulamento na Figura 6.



Figura 6 - Encapsulamento de componentes ativos

Fonte: Nome, Data.

2.5.2 Diodos

O diodo é um semicondutor que permite a passagem de corrente elétrica somente em uma direção, e é por essa característica que ele é um componente muito utilizado para proteção de circuitos eletrônicos além de ser usado como retificador transformando a corrente alternada em contínua. O diodo SMD pode ter formatos distintos dependendo de seu modelo, um dos encapsulamentos bastante utilizados é o DO-214 Fitado. Veja a Figura 7.

Figura 7 - Diodo encapsulamento DO-214



Fonte: Nome, Data.

(breve explicação do diodo da figura 7).

2.5.3 Transistores

O transistor foi uma importante invenção que contribuiu com o avanço tecnológico que pode se observar atualmente, o transistor é um semicondutor usado principalmente amplificador ou como chave em circuitos eletrônicos por sua característica de poder permitir ou não a passagem de corrente elétrica, porém é importante ressaltar que sua aplicação pode ir muito além sendo usado em circuitos complexos como um processador. É muito comum se ver o transistor SMD no encapsulamento SOT-xxx onde xxx é um número variável dependendo de seu modelo. Vide Figura 8.

Figura 8 - Transistor SMD



Fonte: Nome, Data.

(breve explicação do transistor).

2.5.4 Circuitos Integrados (CIs)

Os Circuitos integrados são componentes muito utilizados e bem diversos podendo variar dependendo de cada aplicação, são componentes que contêm resistores, capacitores, transistores etc. dentro de si, esses Cis são capazes de fazer desde funções simples até funções complexas. São componentes muito utilizados em placas eletrônicas tanto em PHT como SMD. Vide Figura 9.



Figura 9 - Regulador de Tensão SMD

Fonte: Nome, Data.

(breve explicação do CI).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Indica que o resultado do trabalho possibilita reflexões, sem uma **conclusão** definitiva **ou** com resultado suscetível de revisões.

REFERENCIAS

PEREIRA, Felipe. **Saber eletrônica:** minicurso arduino. 454. ed. Belo Horizonte: Saber, 2011.

ANEXOS

Os **anexos** são documentos, textos ou ilustrações que foram utilizados pelo autor para a escrita do seu **trabalho**.